

Todos los productos de HIMA nombrados en el presente manual son marcas registradas. Salvo donde se indique lo contrario, esto se aplicará también a los demás fabricantes aquí citados y a sus productos.

Tras haber sido redactadas cuidadosamente, las notas y las especificaciones técnicas ofrecidas en este manual han sido compiladas bajo estrictos controles de calidad. En caso de dudas, consulte directamente a HIMA. HIMA le agradecerá que nos haga saber su opinión acerca de p. ej. qué más información debería incluirse en el manual.

Reservado el derecho a modificaciones técnicas. HIMA se reserva asimismo el derecho de actualizar el material escrito sin previo aviso.

Hallará más información en la documentación recogida en el CD-ROM y en nuestros sitios web http://www.hima.com.

© Copyright 2015, HIMA Paul Hildebrandt GmbH

Todos los derechos reservados.

Contacto

Dirección de HIMA:

HIMA Paul Hildebrandt GmbH

Apdo. Postal / Postfach 1261

D-68777 Brühl

Tel.: +49 6202 709-0

Fax: +49 6202 709-107

Correo electrónico: info@hima.com

	Modificaciones	Tipo de modificación	
revisiones		técnica	redaccional
4.00	Primera edición del manual de SILworX V4 1ª edición en español		

Índice de contenidos

1	Introducción	5
1.1	Estructuración y uso del manual	5
1.2	Destinatarios	5
1.3	Convenciones de representación	6
1.3.1 1.3.2	Notas de seguridad Notas de uso	
2	Seguridad	8
2.1	Uso conforme a la finalidad prevista	8
2.1.1	Condiciones ambientales	
2.1.2	Precauciones contra descargas electrostáticas	
2.2	Peligros remanentes	
2.3	Medidas de seguridad	
2.4	Información para emergencias	
3	Descripción del producto	10
3.1	Función de seguridad	11
3.1.1	Reacción en caso de error	11
3.2	Volumen de suministro	11
3.3	Placa de tipo	11
3.4	Composición	12
3.4.1	Diagrama de bloques	
3.4.2 3.4.3	LecturaIndicadores de estado de módulo	
3.4.4	Indicadores de bus de sistema	
3.4.5	Indicadores de E/S	16
3.5	Datos del producto	
3.6	Tarjetas de conexión	
3.6.1	Codificación mecánica de tarjetas de conexión	
3.6.2 3.6.3	Codificación de tarjetas de conexión X-CB 009 5X Tarjetas de conexión con bornes de rosca	
3.6.4	Asignación de bornes de tarjetas de conexión con bornes de rosca	
3.6.5	Tarjetas de conexión con conector de cables	
3.6.6	Asignación de conectores de tarjetas de conexión con conector de cables	
3.7	Cable de sistema X-CA 006	_
3.7.1	Codificación de conectores de cable	
Λ	Puesta en servicio	20

4.1	Montaje	28
4.1.1	Circuitado de las salidas no utilizadas	28
4.2	Instalación y desmontaje del módulo	29
4.2.1	Montaje de una tarjeta de conexión	29
4.2.2	Instalación y desmontaje de un módulo	31
4.3	Configuración del módulo en SILworX	33
4.3.1	Ficha "Module"	
4.3.2	Ficha I/O Submodule DO32_51	
4.3.3 4.3.4	Ficha I/O Submodule DO32_51: Channels	
4.3.5	Diagnostic Status [DWORD]	
4.4	Variantes de conexión	39
4.4.1	Circuitado de actuadores mediante conexión monopolo	39
4.4.2	Circuitado de actuadores mediante conexión a dos polos	
4.4.3	Circuitado redundante de actuadores	
4.4.4 4.4.5	Circuitado de cargas inductivas Conexión de actuadores mediante terminación FTA (Field Termination Ass	
4.4.5	Conexion de actuadores mediante terminación i TA (i leid Terminatión Ass	
5	Funcionamiento	
5.1	Manejo	42
5.2	Diagnóstico	
6	Mantenimiento	43
6.1	Tareas de mantenimiento	43
6.1.1	Carga del sistema operativo	43
6.1.2	Ensayo de prueba	
7	Puesta fuera de servicio	44
8	Transporte	45
9	Desecho	46
	Anexo 47	
	Glosario	47
	Índice de ilustraciones	48
	Índice de tablas	49
	Índice alfabético	50

X-DO 32 51 1 Introducción

1 Introducción

El presente manual describe las características técnicas del módulo y sus posibles usos. El manual contiene información relativa a la instalación, la puesta en servicio y la configuración en SILworX.

1.1 Estructuración y uso del manual

El contenido de este manual es parte de la descripción del hardware del sistema electrónico programable HIMax.

El manual se divide en los siguientes capítulos principales:

- Introducción
- Seguridad
- Descripción del producto
- Puesta en servicio
- Funcionamiento
- Conservación
- Puesta fuera de servicio
- Transporte
- Desecho

Deberán observarse además los siguientes documentos:

Name	Contenido	Documento Nº
Manual del sistema HIMax	Descripción del hardware del sistema HIMax	HI 801 141 ES
Manual de seguridad HIMax	Funciones de seguridad del sistema HIMax	HI 801 196 ES
Manual de comunicación HIMax	Descripción de la comunicación y los protocolos	HI 801 195 ES
Ayuda en pantalla de SILworX (OLH)	Manejo de SILworX	-
Primeros pasos	Introducción al SILworX	HI 801 194 ES

Tabla 1: Manuales vigentes adicionales

Los manuales actuales se hallan en la página web de HIMA: www.hima.com. Con ayuda del índice de revisión del pie de página podrá compararse la vigencia de los manuales que se tengan respecto a la edición que figura en internet.

1.2 Destinatarios

Este documento va dirigido a planificadores, proyectadores y programadores de equipos de automatización y al personal autorizado para la puesta en servicio, operación y mantenimiento de dispositivos y sistemas. Se presuponen conocimientos especiales en materia de sistemas de automatización con funciones relacionadas con la seguridad.

HI 801 225 ES Rev. 4.00 Página 5 de 52

1 Introducción X-DO 32 51

1.3 Convenciones de representación

Para una mejor legibilidad y comprensión, en este documento se usa la siguiente notación:

Negrita Remarcado de partes importantes del texto.

Designación de botones de software, fichas e ítems de menús

de SILworX sobre los que puede hacerse clic

Coursiva Variables y parámetros del sistema
Coursier Entradas literales del operador

RUN Designación de estados operativos en mayúsculas

Cap. 1.2.3 Las referencias cruzadas son enlaces, aun cuando no estén

especialmente marcadas como tales. Al colocar el puntero sobre un enlace tal, cambiará su aspecto. Haciendo clic en él, se saltará

a la correspondiente página del documento.

Las notas de seguridad y uso están especialmente identificadas.

1.3.1 Notas de seguridad

Las notas de seguridad del documento se representan de la siguiente forma.

Para garantizar mínimos niveles de riesgo, deberá seguirse sin falta lo que indiquen.

Los contenidos se estructuran en

- Palabra señalizadora: peligro, advertencia, precaución, nota
- Tipo y fuente de peligro
- Consecuencias del peligro
- Prevención del peligro

▲ PALABRA SEÑALIZADORA



¡Tipo y fuente de peligro! Consecuencias del peligro Prevención del peligro

Las palabras señalizadoras significan

- Peligro: su inobservancia originará lesiones graves o mortales
- Advertencia: su inobservancia puede originar lesiones graves o mortales
- Precaución: su inobservancia puede originar lesiones moderadas

NOTA



¡Tipo y fuente del daño! Prevención del daño

Página 6 de 52 HI 801 225 ES Rev. 4.00

X-DO 32 51 1 Introducción

1.3.2 Notas de uso La información adicional se estructura como sigue: i En este punto figura el texto con la información adicional. Los trucos y consejos útiles aparecen en la forma: SUGERENCIA En este punto figura el texto con la sugerencia.

HI 801 225 ES Rev. 4.00 Página 7 de 52

2 Seguridad X-DO 32 51

2 Seguridad

En ningún caso deje sin leer las siguientes informaciones de seguridad, las notas y las instrucciones. Use el producto siempre cumpliendo todas las directivas y las recomendaciones de seguridad.

Este producto se usa con SELV o PELV. El módulo en sí no constituye ninguna fuente de peligro. El uso en áreas explosivas sólo se autoriza si se toman medidas adicionales.

2.1 Uso conforme a la finalidad prevista

Los componentes HIMax van destinados a conformar sistemas de control con función relacionada con la seguridad.

Para hacer uso de estos componentes en sistemas HIMax deberán cumplirse las siguientes condiciones.

2.1.1 Condiciones ambientales

Tipo de condición	Rango de valores
Clase de protección	Clase de protección III según IEC/EN 61131-2
Temperatura ambiente	0+60 °C
Temperatura de almacenamiento	-40+85 °C
Polución	Grado de polución II según IEC/EN 61131-2
Altitud de emplazamiento	< 2000 m
Carcasa	Estándar: IP20
Tensión de alimentación	24 VCC

Tabla 2: Condiciones ambientales

En condiciones ambientales distintas a las especificadas en este manual es posible que el sistema HIMax sufra disfunciones.

2.1.2 Precauciones contra descargas electrostáticas

Las modificaciones o ampliaciones del sistema, así como la sustitución de módulos, únicamente deberán ser realizas por personal con conocimientos sobre medidas de protección contra descargas electrostáticas.

NOTA



¡Daños en los dispositivos por descarga electrostática!

- Realice estas tareas en un lugar de trabajo antiestático y llevando una cinta de puesta a tierra.
- Guarde bien protegidos (p. ej. en su embalaje original) los dispositivos que no tenga en uso.

Página 8 de 52 HI 801 225 ES Rev. 4.00

X-DO 32 51 2 Seguridad

2.2 Peligros remanentes

Un módulo HIMax en sí no representa ninguna fuente de peligro.

Lo siguiente puede conllevar peligros remanentes:

- Errores de realización del proyecto
- Errores en el programa de usuario
- Errores en el cableado

.

2.3 Medidas de seguridad

Respete las normas de seguridad vigentes en el lugar de uso y use la debida indumentaria de seguridad personal.

2.4 Información para emergencias

Un sistema de control HIMax forma parte del equipamiento de seguridad de una planta. Si el sistema de control deja de funcionar, la planta adoptará un estado seguro.

En caso de emergencia está prohibida toda intervención que impida la función de seguridad de los sistemas HIMax.

HI 801 225 ES Rev. 4.00 Página 9 de 52

3 Descripción del producto

El módulo estándar X-DO 32 51 es un módulo digital de salida que sirve para usar en el sistema electrónico programable (PES) de HIMax.

El módulo puede aplicarse en todos los slots del rack, excepto en los slots para los módulos de bus de sistema. Más información en el manual de sistema HI 801 141 ES.

El módulo está equipado con 32 salidas digitales, las cuales admiten una intensidad nominal de 0,5 A por canal. Con el nivel High (nivel H) habrá en la salida correspondiente una tensión igual a la tensión de alimentación.

Las salidas valen para conectar a ellas cargas óhmicas, inductivas, capacitivas y lámparas.

El módulo estándar podrá hacerse operar en un rack junto con módulos relacionados con la seguridad.

El módulo estándar no tiene repercusiones sobre los módulos relacionados con la seguridad. Esto incluye particularmente la CEM, la seguridad eléctrica, la comunicación a X-SB y X-CPU y el programa del usuario.

Módulo y tarjeta de conexión están mecánicamente codificados. Véase el capítulo 3.6.1. Así se evita que un módulo con función relacionada con la seguridad sea sustituido por un módulo estándar.

Las normas aplicadas para la verificación y certificación de los módulos y el sistema HIMax constan en el manual del sistema HIMax HI 801 196 ES.

Página 10 de 52 HI 801 225 ES Rev. 4.00

3.1 Función de seguridad

El módulo no ejecuta ninguna función relacionada con la seguridad.

Cada switch de un canal puede desconectarse por separado mediante el bus del sistema (bus de E/S) o mediante la segunda vía de desconexión independiente (WatchDog).

Los parámetros y estados del módulo no podrán usarse para funciones relacionadas con la seguridad.

3.1.1 Reacción en caso de error

Si se trata de un error de canal, se desactivará el canal afectado. Si es un error de módulo, se desactivarán todas las salidas.

En caso de fallar los buses del sistema se desconectará la energía a las salidas.

El módulo activará el LED Error en el panel frontal.

3.2 Volumen de suministro

Para funcionar el módulo necesita la correspondiente tarjeta de conexión. Si se usa un FTA se necesitará un cable de sistema para conectar la tarjeta de conexión al FTA. Las tarjetas de conexión, el cable de sistema y los FTA no se incluyen en el volumen de suministro del módulo.

Las tarjetas de conexión se describen en el capítulo 3.6, los cables de sistema en el capítulo 3.7 y los FTA en sus respectivos manuales.

3.3 Placa de tipo

La placa de tipo contiene estos datos importantes:

- Nombre del producto
- Distintivo de homologación
- Código de barras (código 2D o líneas)
- Nº de referencia (Part-No.)
- Índice de revisión del hardware (HW-Rev.)
- Índice de revisión del software (SW-Rev.)
- Tensión de trabajo (Power)
- Especificaciones EX (si procede)
- Año de fabricación (Prod-Year:)



Fig. 1: Ejemplo de placa de tipo

HI 801 225 ES Rev. 4.00 Página 11 de 52

3.4 Composición

El módulo está equipado con 32 salidas digitales. Las salidas están separadas galvánicamente entre sí, así como de la tensión de alimentación.

El módulo está equipado con un limitador de corriente que limita la intensidad de las 32 salidas. Además, cada una de las salidas está protegida contra sobrecargas.

Si el limitador de corriente detecta una sobrecarga, se desactivarán todas las salidas y volverán a conectarse tras diez segundos. Si la sobrecarga persiste, se desconectarán de nuevo todas las salidas durante diez segundos. Este procedimiento se repetirá hasta que deje de existir la sobrecarga.

En caso de sobrecarga de una salida se desactivarán todas las salidas y volverán a conectarse tras diez segundos. Si la sobrecarga persiste, se desconectarán de nuevo las salidas durante diez segundos. Este procedimiento se repetirá hasta que deje de existir la sobrecarga.

Si se desea impedir la reconexión cíclica en caso de sobrecarga, ello deberá implementarse así en el programa del usuario.

El sistema procesador del módulo de E/S dirige y monitorea el nivel de E/S. Los datos y estados del módulo de E/S se transmiten a los módulos procesadores mediante el bus redundante del sistema. Por razones de disponibilidad, el bus del sistema se implementa de forma redundante. La redundancia sólo estará garantizada cuando ambos módulos de bus de sistema se hayan introducido en el rack y se hayan configurado en SILworX.

Los LED indican el estado de las salidas digitales. Véase el capítulo 3.4.2.

Página 12 de 52 HI 801 225 ES Rev. 4.00

3.4.1 Diagrama de bloques

El siguiente diagrama de bloques muestra la estructura del módulo:

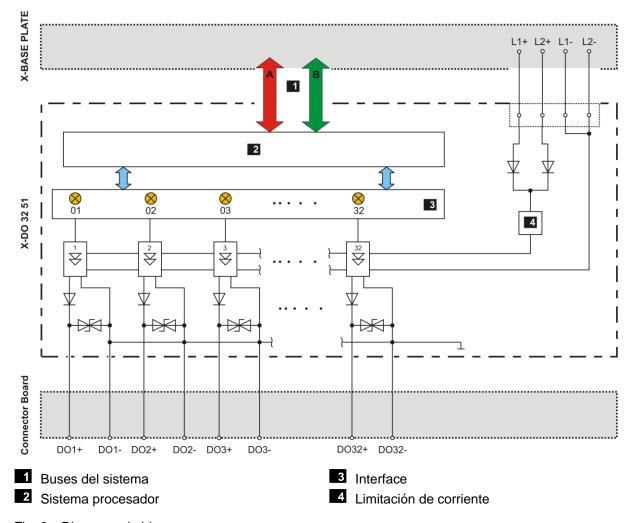


Fig. 2: Diagrama de bloques

HI 801 225 ES Rev. 4.00 Página 13 de 52

3.4.2 Lectura

La siguiente figura reproduce la lectura del módulo:

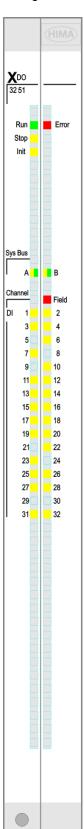


Fig. 3: Lectura

Los LED indican el estado operativo del módulo.

Página 14 de 52 HI 801 225 ES Rev. 4.00

Los LED del módulo se dividen en estas categorías:

- Indicadores de estado del módulo (Run, Error, Stop, Init)
- Indicadores de bus de sistema (A, B)
- Indicadores de E/S (DO 1...32)

Al conectarse la tensión de alimentación tendrá lugar siempre una prueba de LEDs, durante la cual se encenderán brevemente todos los LED.

Definición de las frecuencias de parpadeo:

En la siguiente tabla se definen las frecuencias de parpadeo de los LED:

Name	Frecuencia de parpadeo
Parpadeo1	Largo (600 ms) encendido, largo (600 ms) apagado
Parpadeo2	Corto (200 ms) encendido, corto (200 ms) apagado, corto (200 ms) encendido, largo (600 ms) apagado
Parpadeo X	Comunicación Ethernet: Parpadeo sincronizado con la transmisión de datos

Tabla 3: Frecuencias de parpadeo de los LED

3.4.3 Indicadores de estado de módulo

Estos LED se hallan en la parte de arriba de la placa frontal.

LED	Color	Estado	Significado
Run	Verde	Encendido	Módulo en estado RUN, funcionamiento normal
		Parpadeo1	Módulo en estado STOP/OS_DOWNLOAD o RUN/UP STOP (sólo en módulos procesadores)
		Apagado	Módulo no en estado RUN, observar otros LED de estado
Error	Rojo	Encendido/ Parpadeo1	Fallos internos del módulo detectados por la autocomprobación, p. ej. errores de hardware y de software o fallos de la fuente de alimentación. Errores al cargar el sistema operativo
		Apagado	Funcionamiento normal
Stop	Amarillo	Encendido	Módulo en estado STOP/VALID CONFIGURATION
		Parpadeo1	Módulo en estado STOP/INVALID CONFIGURATION o STOP/OS_DOWNLOAD
		Apagado	Módulo no en estado STOP, observar otros LED de estado
Init	Amarillo	Encendido	Módulo en estado INIT
		Parpadeo1	Módulo en estado LOCKED
		Apagado	Módulo no en estado INIT ni LOCKED, observar otros LED de estado

Tabla 4: Indicadores de estado de módulo

HI 801 225 ES Rev. 4.00 Página 15 de 52

3.4.4 Indicadores de bus de sistema

Los LED indicadores de bus de sistema están rotulados con Sys Bus.

LED	Color	Estado	Significado
A Verde Ence		Encendido	Conexión física y lógica al módulo de bus de sistema en el slot 1
		Parpadeo1	Sin conexión al módulo de bus de sistema en el slot 1
	Amarillo	Parpadeo1	Conexión física establecida al módulo de bus de sistema en el slot 1
			Sin conexión a un módulo procesador (redundante) en el funcionamiento del sistema
В	Verde	Encendido	Conexión física y lógica al módulo de bus de sistema en el slot 2
		Parpadeo1	Sin conexión al módulo de bus de sistema en el slot 2
	Amarillo	Parpadeo1	Conexión física establecida al módulo de bus de sistema en el slot 2 Sin conexión a un módulo procesador (redundante) en el funcionamiento del sistema
A+B	Apagado	Apagado	Sin conexión física ni lógica a los módulos del bus del sistema en los slots 1 y 2.

Tabla 5: Indicadores de bus de sistema

3.4.5 Indicadores de E/S

Los LED que indican las E/S están rotulados con Channel.

LED	Color	Estado	Significado
Channel	Amarillo	Encendido	Nivel High aplicado
132		Parpadeo2	Error de canal
		Apagado	Nivel Low aplicado
Field	Rojo	Parpadeo2	Error de campo en al menos un canal
		Apagado	Sin errores en campo

Tabla 6: LED indicadores de E/S

Página 16 de 52 HI 801 225 ES Rev. 4.00

3.5 Datos del producto

Generalidades		
Tensión de alimentación	24 VCC, -15%+20%, w _s ≤ 5%, SELV, PELV	
Amperaje	Mín. 0,5 A (marcha sin carga)	
	Máx. 12,5 A	
Temperatura de trabajo	0 °C+60 °C	
Temperatura de almacenamiento	-40 °C+85 °C	
Humedad	máx. 95% de humedad relativa, sin rocío	
Grado de protección	IP20	
Dimensiones (H x A x Prof) en mm	310 x 29,2 x 230	
Masa	aprox. 1,1 kg	

Tabla 7: Datos del producto

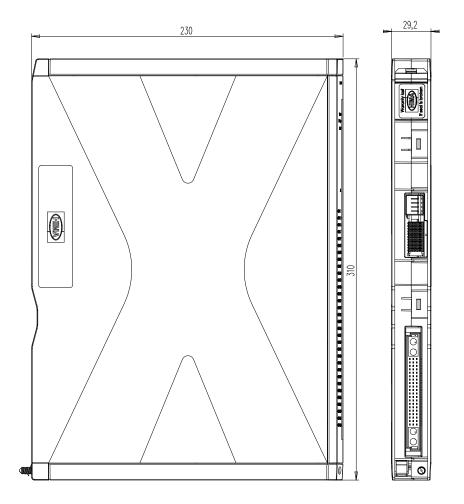


Fig. 4: Vistas

HI 801 225 ES Rev. 4.00 Página 17 de 52

Salidas digitales	
Cantidad de salidas (cantidad de canales)	32, no separadas galvánicamente
Tensión de salida	L+ menos la caída interna de tensión
Caída de tensión (en el nivel H)	1,8 V a 0,75 A de intensidad de salida
Intensidad de diseño (en el nivel H)	0,5 A, rango de 00,6 A
Intensidad total admisible del módulo	12 A
Corriente de fuga (en el nivel L)	5 μΑ
Limitación de corriente	1,7 A por canal
en caso de cortocircuito	
Desconexión por sobreintensidad	I > 0,8 A durante t > 50 ms
Carga óhmica	Hasta intensidad nom. de diseño de 0,5 A
Carga inductiva	15 H
Carga capacitiva	100 μF
Caga de lámparas (24V)	4 W
Protección de sobretensión de las salidas,	33 V (máx. 43 V)
transitorios	
Nivel de las salidas	
En el nivel L	máx. 1 V a L+ = 24 V (mín. carga 200 kΩ)
En el nivel H	mín. 22,2 V a L+ = 24 V (máx. carga 32 Ω)
Tiempo de conmutación de los canales	≤ 100 µs
(con carga óhmica)	
Impulsos de prueba (con carga óhmica)	200 μs
Comportamiento en caso de sobrecarga	Desactivación de la salida afectada
	con intentos cíclicos de reconexión

Tabla 8: Datos de las salidas digitales

Página 18 de 52 HI 801 225 ES Rev. 4.00

3.6 Tarjetas de conexión

Una tarjeta de conexión conecta el módulo al nivel de campo. Módulo y tarjeta de conexión conforman juntos una unidad funcional. Antes de instalar el módulo, monte la tarjeta de conexión en el slot previsto.

Para el módulo se dispone de las siguientes tarjetas de conexión:

Designación	Descripción
X-CB 009 51	Tarjeta de conexión con bornes de rosca
X-CB 009 52	Tarjeta de conexión redundante con bornes de rosca
X-CB 009 53	Tarjeta de conexión con conector de cables
X-CB 009 54	Tarjeta de conexión redundante con conector de cables

Tabla 9: Tarjetas de conexión disponibles

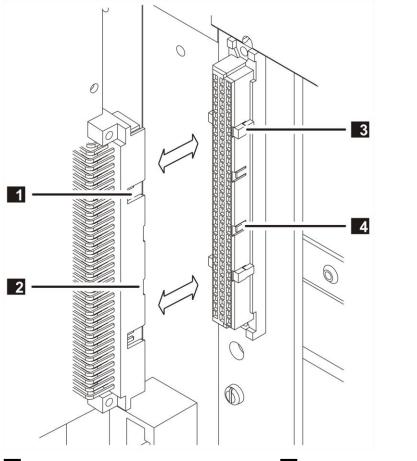
3.6.1 Codificación mecánica de tarjetas de conexión

Los módulos de E/S y las tarjetas de conexión están mecánicamente codificados a partir de la versión AS 00 del hardware, para evitar el montaje de módulos de E/S inadecuados. La codificación impide montar elementos equivocados y evita así repercusiones sobre el campo y módulos redundantes. Además, el montaje de elementos equivocados no afecta en absoluto al sistema HIMax, ya que sólo los módulos correctamente configurados en SILworX adoptarán el estado RUN.

Los módulos de E/S y sus correspondientes tarjetas de conexión están dotados de una codificación mecánica en forma de cuñas. Las cuñas de codificación de la regleta de resorte de la tarjeta de conexión encajan en las escotaduras de la regleta del conector del módulo de E/S, véase Fig. 5.

Los módulos de E/S codificados sólo encajarán en las tarjetas de conexión correspondientes.

HI 801 225 ES Rev. 4.00 Página 19 de 52



Escotadura de regleta

- 3 Cuña de codificación
- 2 Escotadura de regleta preparada
- 4 Guía para cuña de codificación

Fig. 5: Ejemplo de una codificación

Los módulos de E/S codificados encajarán también en tarjetas de conexión sin codificar. Los módulos de E/S no codificados no encajarán en tarjetas de conexión codificadas.

3.6.2 Codificación de tarjetas de conexión X-CB 009 5X

a7	a13	a20	a26	с7	c13	c20	c26
Χ	X	X				X	

Tabla 10: Posición de las cuñas de codificación

Página 20 de 52 HI 801 225 ES Rev. 4.00

3.6.3 Tarjetas de conexión con bornes de rosca

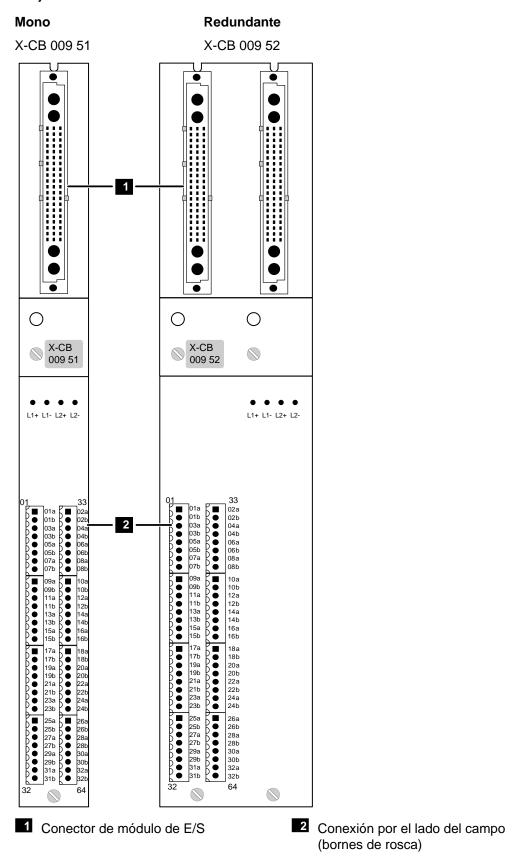


Fig. 6: Tarjetas de conexión con bornes de rosca

HI 801 225 ES Rev. 4.00 Página 21 de 52

3.6.4 Asignación de bornes de tarjetas de conexión con bornes de rosca

Nº de pin	Designación	Señal	Nº de pin	Designación	Señal
1	01a	DO1+	1	02a	DO2+
2	01b	DO1-	2	02b	DO2-
3	03a	DO3+	3	04a	DO4+
4	03b	DO3-	4	04b	DO4-
5	05a	DO5+	5	06a	DO6+
6	05b	DO5-	6	06b	DO6-
7	07a	DO7+	7	08a	DO8+
8	07b	DO7-	8	08b	DO8-
Nº de pin	Designación	Señal	Nº de pin	Designación	Señal
1	09a	DO9+	1	10a	DO10+
2	09b	DO9-	2	10b	DO10-
3	11a	DO11+	3	12a	DO12+
4	11b	DO11+	4	12b	DO12-
5	13a	DO13+	5	14a	DO14+
6	13b	DO13-	6	14b	DO14-
7	15a	DO15+	7	16a	DO16+
8	15b	DO15-	8	16b	DO16-
0			_		
Nº de pin	Designación	Señal	Nº de pin	Designación	Señal
			Nº de pin		
Nº de pin 1 2	Designación	Señal	Nº de pin 1 2	Designación	Señal
Nº de pin	Designación 17a	Señal DO17+	Nº de pin	Designación 18a	Señal DO18+
Nº de pin 1 2	Designación 17a 17b	Señal DO17+ DO17-	Nº de pin 1 2	Designación 18a 18b	Señal DO18+ DO18-
Nº de pin 1 2 3	Designación 17a 17b 19a	Señal DO17+ DO17- DO19+	Nº de pin 1 2 3	Designación 18a 18b 20a	Señal DO18+ DO18- DO20+
Nº de pin 1 2 3 4	Designación 17a 17b 19a 19b	Señal DO17+ DO17- DO19+ DO19-	Nº de pin 1 2 3 4	Designación 18a 18b 20a 20b	Señal DO18+ DO18- DO20+ DO20-
Nº de pin 1 2 3 4 5	Designación 17a 17b 19a 19b 21a	Señal DO17+ DO17- DO19+ DO19- DO21+	Nº de pin 1 2 3 4 5	Designación 18a 18b 20a 20b 22a	Señal DO18+ DO18- DO20+ DO20- DO22+
Nº de pin 1 2 3 4 5	Designación 17a 17b 19a 19b 21a 21b	Señal DO17+ DO17- DO19+ DO19- DO21+ DO21-	Nº de pin 1 2 3 4 5	Designación 18a 18b 20a 20b 22a 22b	Señal DO18+ DO18- DO20+ DO20- DO22+ DO22-
Nº de pin 1 2 3 4 5 6 7	Designación 17a 17b 19a 19b 21a 21b 23a	Señal DO17+ DO17- DO19+ DO19- DO21+ DO21- DO23+	Nº de pin 1 2 3 4 5 6 7	Designación 18a 18b 20a 20b 22a 22b 24a	Señal DO18+ DO18- DO20+ DO20- DO22+ DO22- DO24+
Nº de pin 1 2 3 4 5 6 7	Designación 17a 17b 19a 19b 21a 21b 23a 23b	Señal DO17+ DO17- DO19+ DO19- DO21+ DO21- DO23+ DO23-	Nº de pin 1 2 3 4 5 6 7 8 Nº de pin 1	Designación 18a 18b 20a 20b 22a 22b 24a 24b	Señal DO18+ DO18- DO20+ DO20- DO22+ DO22- DO24+ DO24-
Nº de pin 1 2 3 4 5 6 7 8 Nº de pin	Designación 17a 17b 19a 19b 21a 21b 23a 23b Designación	Señal DO17+ DO17- DO19+ DO19- DO21+ DO21- DO23+ DO23- Señal	Nº de pin 1 2 3 4 5 6 7 8 Nº de pin 1 2	Designación 18a 18b 20a 20b 22a 22b 24a 24b Designación	Señal DO18+ DO18- DO20+ DO20- DO22+ DO22- DO24+ DO24- Señal
Nº de pin 1 2 3 4 5 6 7 8 Nº de pin 1	Designación 17a 17b 19a 19b 21a 21b 23a 23b Designación 25a	Señal DO17+ DO17- DO19+ DO19- DO21+ DO21- DO23+ DO23- Señal DO25+	Nº de pin 1 2 3 4 5 6 7 8 Nº de pin 1	Designación 18a 18b 20a 20b 22a 22b 24a 24b Designación 26a	Señal DO18+ DO18- DO20+ DO20- DO22+ DO22- DO24+ DO24- Señal DO26+
Nº de pin 1 2 3 4 5 6 7 8 Nº de pin 1 2 3 4	Designación 17a 17b 19a 19b 21a 21b 23a 23b Designación 25a 25b 27a 27b	Señal DO17+ DO17- DO19+ DO19- DO21+ DO21- DO23- Señal DO25+ DO25-	Nº de pin 1 2 3 4 5 6 7 8 Nº de pin 1 2 3 4 4 4	Designación 18a 18b 20a 20b 22a 22b 24a 24b Designación 26a 26b	Señal DO18+ DO18- DO20+ DO20- DO22+ DO22- DO24+ DO24- Señal DO26+ DO26-
Nº de pin 1 2 3 4 5 6 7 8 Nº de pin 1 2 3	Designación 17a 17b 19a 19b 21a 21b 23a 23b Designación 25a 25b 27a	Señal DO17+ DO17- DO19+ DO19- DO21+ DO21- DO23- Señal DO25+ DO25- DO27+	Nº de pin 1 2 3 4 5 6 7 8 Nº de pin 1 2 3	Designación 18a 18b 20a 20b 22a 22b 24a 24b Designación 26a 26b 28a	Señal DO18+ DO18- DO20+ DO20- DO22+ DO22- DO24+ DO24- Señal DO26+ DO26- DO28+
Nº de pin 1 2 3 4 5 6 7 8 Nº de pin 1 2 3 4	Designación 17a 17b 19a 19b 21a 21b 23a 23b Designación 25a 25b 27a 27b	Señal DO17+ DO17- DO19+ DO19- DO21+ DO21- DO23- Señal DO25+ DO25- DO27-	Nº de pin 1 2 3 4 5 6 7 8 Nº de pin 1 2 3 4 4 4	Designación 18a 18b 20a 20b 22a 22b 24a 24b Designación 26a 26b 28a 28b	Señal DO18+ DO18- DO20+ DO20- DO22+ DO22- DO24+ DO24- Señal DO26+ DO26- DO28+ DO28-
Nº de pin 1 2 3 4 5 6 7 8 Nº de pin 1 2 3 4 5 5 5 6 7 8 Nº de pin 1 2 3 4 5	Designación 17a 17b 19a 19b 21a 21b 23a 23b Designación 25a 25b 27a 27b 29a	Señal DO17+ DO17- DO19+ DO19- DO21+ DO21- DO23- Señal DO25+ DO25- DO27+ DO27- DO29+	Nº de pin 1 2 3 4 5 6 7 8 Nº de pin 1 2 3 4 5 5 6 7 8 Nº de pin 1 2 3 4 5	Designación 18a 18b 20a 20b 22a 22b 24b 24b Designación 26a 26b 28a 28b 30a	Señal DO18+ DO18- DO20+ DO20- DO22+ DO22- DO24- Señal DO26- DO26- DO28- DO30+

Tabla 11: Asignación de bornes de tarjetas de conexión con bornes de rosca

Página 22 de 52 HI 801 225 ES Rev. 4.00

La conexión por el lado del campo se realiza con conectores de bornes que se conectan a las regletas de pins de las tarjetas de conexión.

Los conectores de bornes tienen las siguientes características:

Conexión por el lado del campo				
Conectores de bornes	8 unidades, de 8 polos			
Sección transversal de cable	0,21,5 mm² (monohilo) 0,21,5 mm² (de hilo fino) 0,21,5 mm² (con puntera terminal)			
Longitud de pelado	6 mm			
Destornillador	Ranura 0,4 x 2,5 mm			
Par de apriete	0,20,25 Nm			

Tabla 12: Características de los conectores de bornes

HI 801 225 ES Rev. 4.00 Página 23 de 52

3.6.5 Tarjetas de conexión con conector de cables

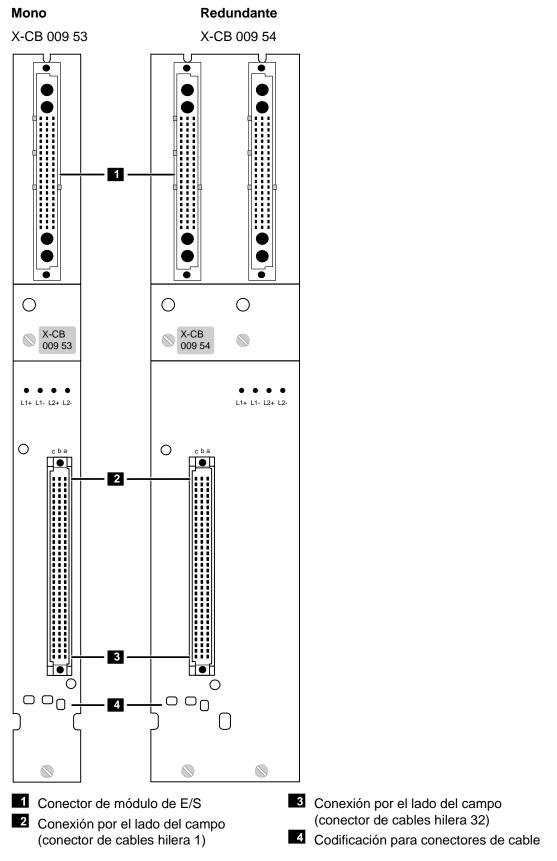


Fig. 7: Tarjetas de conexión con conector de cables

Página 24 de 52 HI 801 225 ES Rev. 4.00

3.6.6 Asignación de conectores de tarjetas de conexión con conector de cables Para estas tarjetas de conexión, HIMA ofrece cables de sistema preconfeccionados. Véase el capítulo 3.7. Tarjetas de conexión y conectores de cables están codificados.

Asignación de conectores

La siguiente tabla describe la asignación de conectores del cable del sistema.

Designación de hilos conforme a DIN 47100:

Hilera	С		b		а	
Пінета	Señal	Color	Señal	Color	Señal	Color
1	DO32+	pk-bn ¹⁾	DO32-	wh-pk ¹⁾	reservado	bn-rd ²⁾
2	DO31+	gy-bn ¹⁾	DO31-	wh-gy 1)	reservado	wh-rd ²⁾
3	DO30+	ye-bn 1)	DO30-	wh-ye 1)	reservado	bn-bu ²⁾
4	DO29+	bn-gn 1)	DO29-	wh-gn 1)	reservado	wh-bu ²⁾
5	DO28+	rd-bu ¹⁾	DO28-	gy-pk 1)		
6	DO27+	vt ¹⁾	DO27-	bk ¹⁾		
7	DO26+	rd ¹⁾	DO26-	bu ¹⁾		
8	DO25+	pk ¹⁾	DO25-	gy 1)		
9	DO24+	ye ¹⁾	DO24-	gn ¹⁾		
10	DO23+	bn ¹⁾	DO23-	wh 1)		
11	DO22+	rd-bk	DO22-	bu-bk		
12	DO21+	pk-bk	DO21-	gy-bk		
13	DO20+	pk-rd	DO20-	gy-rd		
14	DO19+	pk-bu	DO19-	gy-bu		
15	DO18+	ye-bk	DO18-	gn-bk		
16	DO17+	ye-rd	DO17-	gn-rd		
17	DO16+	ye-bu	DO16-	gn-bu		
18	DO15+	ye-pk	DO15-	pk-gn		
19	DO14+	ye-gy	DO14-	gy-gn		
20	DO13+	bn-bk	DO13-	wh-bk		
21	DO12+	bn-rd	DO12-	wh-rd		
22	DO11+	bn-bu	DO11-	wh-bu		
23	DO10+	pk-bn	DO10-	wh-pk		
24	DO9+	gy-bn	DO9-	wh-gy		
25	DO8+	ye-bn	DO8-	wh-ye		
26	DO7+	bn-gn	DO7-	wh-gn		
27	DO6+	rd-bu	DO6-	gy-pk		
28	DO5+	vt	DO5-	bk		
29	DO4+	rd	DO4-	bu		
30	DO3+	pk	DO3-	gy		
31	DO2+	ye	DO2-	gn		
32	DO1+	bn	DO1-	wh		

Anillo adicional naranja en caso de repetirse el color de la designación de hilos.

Tabla 13: Asignación de conectores del cable del sistema

HI 801 225 ES Rev. 4.00 Página 25 de 52

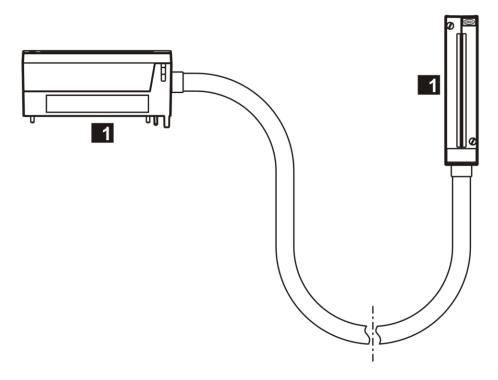
²⁾ Anillo adicional violeta para la segunda repetición del color de la designación de hilos.

3.7 Cable de sistema X-CA 006

El cable del sistema X-CA 006 conecta las tarjetas de conexión X-CB 009 53/54 a las terminaciones de campo (FTA).

Generalidades				
Cable	LIYY 64 x 0,34 mm ² +			
	2 x 2 x 0,25 mm ²			
Conductor	De hilo fino			
Diámetro exterior medio (d)	aprox. 17,2 mm			
Mínimo radio de curvatura				
Tendido fijo	5 x d			
Tendido móvil	10 x d			
Respuesta frente al fuego	Resistente a llama y autoextinguible conforme a IEC 60332-1-2, -2-2			
Longitud	830 m			
Codificación por colores	Conforme a DIN 47100, véase Tabla 13.			

Tabla 14: Datos de cables



Conectores de cable idénticos

Fig. 8: X-CA 006 01 n

El cable del sistema puede suministrarse en las siguientes variantes estándar:

Cable del sistema	Descripción	Longitud
X-CA 006 01 8	Conectores de cables codificados a ambos lados.	8 m
X-CA 006 01 15		15 m
X-CA 006 01 30		30 m

Tabla 15: Cables de sistema disponibles

Página 26 de 52 HI 801 225 ES Rev. 4.00

3.7.1 Codificación de conectores de cable

Los conectores de cables tienen tres clavijas de codificación. Así, los conectores podrán conectarse únicamente a tarjetas de conexión y FTAs con la correspondiente codificación. Véase Fig. 7.

HI 801 225 ES Rev. 4.00 Página 27 de 52

4 Puesta en servicio X-DO 32 51

4 Puesta en servicio

En este capítulo se describe cómo se instala y configura el módulo, así como sus variantes de conexión. Hallará más información en el manual de seguridad de HIMax HI 801 196 ES.

4.1 Montaje

Para el montaje observe los siguientes puntos:

- Para usar sólo con los correspondientes componentes de ventilación, véase el manual HI 801 141 ES.
- Se permite su uso sólo con la correspondiente tarjeta de conexión.
 Véase el capítulo 3.6.
- El módulo, incluidos sus elementos de conexión, habrá de montarse de tal manera que se tenga por lo menos el grado de protección IP20 según EN 60529: 1991 + A1:2000.

NOTA



¡Daños por conexión incorrecta del circuito! La inobservancia puede dar lugar a daños en elementos electrónicos. Observe los siguientes puntos.

- Bornes y conectores por el lado del campo
 - Al conectar bornes y conectores al lado del campo, preste atención a una puesta a tierra adecuada.
 - Para conectar los circuitos de corriente de campo a las salidas digitales se admite usar un cable no apantallado de par trenzado.
 - Por la parte del módulo tienda el apantallado en el carril de apantallado de cables (use borne de conexión de apantallado SK 20 o equivalente).
 - En el caso de los conductores de varios hilos, HIMA recomienda dotar a los extremos del conductor con punteras terminales. Los bornes de conexión deberán ser aptos para los bornes secundarios de las secciones transversales empleadas.
- Un circuitado redundante de las salidas deberá implementarse mediante las correspondientes tarjetas de conexión. Véase el capítulo 3.6 y 4.4.

4.1.1 Circuitado de las salidas no utilizadas

Las salidas no utilizadas podrán dejarse abiertas, no es necesario usar terminaciones. Para evitar cortocircuitos y chispas en campo no se permitirá conectar a las tarjetas de conexión conductores que tengan extremos abiertos por el lado del campo.

Página 28 de 52 HI 801 225 ES Rev. 4.00

X-DO 32 51 4 Puesta en servicio

4.2 Instalación y desmontaje del módulo

En este capítulo se describe cómo sustituir un módulo existente o colocar un módulo nuevo.

Al retirar el módulo, la tarjeta de conexión permanecerá en el rack HIMax. Esto evita trabajos de cableado adicionales en los bornes de conexión, ya que todas las conexiones de campo se realizan mediante la tarjeta de conexión del módulo.

4.2.1 Montaje de una tarjeta de conexión

Herramientas y medios auxiliares

- Destornillador, ranura de 0,8 x 4,0 mm
- Tarjeta de conexión adecuada

Montaje de la tarjeta de conexión:

- 1. Introduzca la tarjeta de conexión en el carril guía con la ranura hacia arriba (véase al respecto el siguiente dibujo). Encaje la ranura en la espiga del carril guía.
- 2. Emplace la tarjeta de conexión sobre el carril de apantallado de cables.
- 3. Atorníllela al rack con los dos tornillos imperdibles. Primero enrosque el tornillo inferior y luego el superior.

Desmontaje de la tarjeta de conexión:

- 1. Destornille los tornillos imperdibles del rack.
- 2. Separe la tarjeta de conexión por abajo del carril de apantallado.
- 3. Saque la tarjeta de conexión del carril guía.

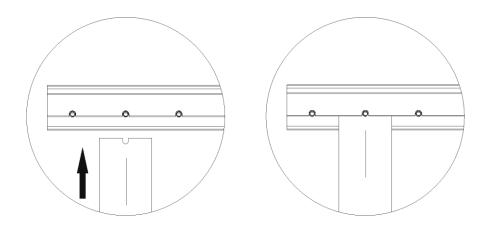


Fig. 9: Colocación de la tarjeta de conexión

HI 801 225 ES Rev. 4.00 Página 29 de 52

4 Puesta en servicio X-DO 32 51

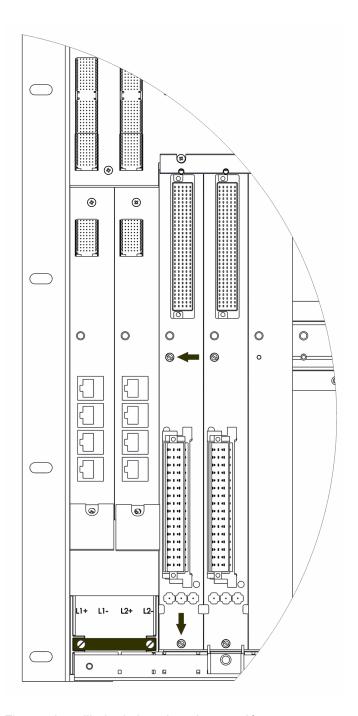


Fig. 10: Atornillado de la tarjeta de conexión

Página 30 de 52 HI 801 225 ES Rev. 4.00

X-DO 32 51 4 Puesta en servicio

4.2.2 Instalación y desmontaje de un módulo

Este capítulo describe cómo se instala y retira un módulo HIMax. Un módulo podrá instalarse y retirarse sin interrumpir el funcionamiento del sistema HIMax.

NOTA



¡Daños de los conectores en caso de introducirlos ladeados! La inobservancia puede dar lugar a daños en el sistema de control. Coloque los módulos siempre con cuidado en su rack.

Herramientas

- Destornillador, ranura de 0,8 x 4,0 mm
- Destornillador, ranura de 1,2 x 8,0 mm

Instalación

- 1. Abra la chapa de cierre del rack del ventilador:
 - ☑ Ponga los bloqueos en posición abierta
 - ☑ Gire la chapa de cierre hacia arriba e introdúzcala en el rack del ventilador
- 2. Coloque el módulo en la parte superior del perfil de suspensión, véase 1.
- 3. Gire el módulo en la parte inferior en la rack y encástrelo con una ligera presión, véase 2.
- 4. Atornille el módulo, véase 3.
- 5. Saque la chapa de cierre hacia arriba del rack del ventilador y gírela hacia abajo.
- Bloquee la chapa de cierre.

Desmontaje

- 1. Abra la chapa de cierre del rack del ventilador:
 - ☑ Ponga los bloqueos en posición abierta
 - ☑ Gire la chapa de cierre hacia arriba e introdúzcala en el rack del ventilador
- 2. Suelte el tornillo, véase 3.
- 3. Gire el módulo para sacarlo de la parte inferior en la rack y desencájelo con una ligera presión hacia arriba del perfil, véase 2 y 1.
- 4. Saque la chapa de cierre hacia arriba del rack del ventilador y gírela hacia abajo.
- 5. Bloquee la chapa de cierre.

HI 801 225 ES Rev. 4.00 Página 31 de 52

4 Puesta en servicio X-DO 32 51

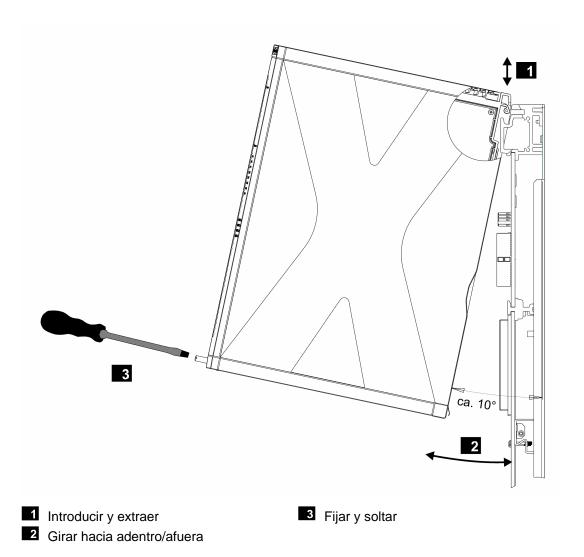


Fig. 11: Instalación y desmontaje de módulo

Durante el funcionamiento del sistema HIMax tenga abierta la chapa de cierre del rack del ventilador brevemente (< 10 min.), pues ello menoscaba la convección forzada.

Página 32 de 52 HI 801 225 ES Rev. 4.00

X-DO 32 51 4 Puesta en servicio

4.3 Configuración del módulo en SILworX

El módulo se configura en el editor de hardware de la utilidad de programación SILworX.

Para la configuración observe los siguientes puntos:

- Para el diagnóstico del módulo y de los canales podrán usarse en el programa del usuario los parámetros del sistema además del valor de medición. Hallará más información sobre los parámetros del sistema en las tablas a partir del capítulo 4.3.1.
- Si se crea un grupo de redundancia, éste se configurará en sus fichas. Las fichas del grupo de redundancia son diferentes de las de los módulos individuales. Véanse las tablas subsiguientes.

Para poder evaluar los parámetros del sistema en el programa del usuario, deberán asignarse variables globales a los parámetros del sistema. Realice este paso dentro del editor de hardware en la vista en detalle del módulo.

Las tablas subsiguientes contienen los parámetros de sistema del módulo en el mismo orden que en el editor de hardware.

SUGE- Para convertir los valores hexadecimales en secuencias de bits puede usarse **RENCIA** p. ej. la calculadora de Windows[®] en su formato "científico".

HI 801 225 ES Rev. 4.00 Página 33 de 52 4 Puesta en servicio X-DO 32 51

4.3.1 Ficha "Module"

La ficha **Module** contiene los siguientes parámetros de sistema del módulo.

Name		R/W	Descripción			
Estos estados y par	escriben	directamente en el editor de hardware.				
Name	W	Nombre del módulo				
Spare Module I	W	Activado: la ausencia de un módulo del grupo de redundancia en el rack no se evaluará como error. Desactivado: la ausencia de un módulo del grupo de redundancia en el rack se evaluará como error. Configuración por defecto: Desactivado ¡Aparece sólo en la ficha del grupo de redundancia!				
Noise Blanking	W	Admitir inhibición de fallos por parte del módulo procesador (activado/desactivado). Configuración por defecto: Activado Los mensajes de estado se inhibirán hasta el tiempo de seguridad. Seguirá obrando el último valor de proceso válido para el programa del usuario.				
Name	Tipo de datos	R/W	Descripción			
Los siguientes estac del usuario.		etros pod	lrán asignarse a v	ariables globales y utilizarse en el programa		
Module OK BOOL		R	TRUE: Modo mono: sin errores de módulo. Modo en redundancia: al menos uno de los módulos redundantes no tiene un error de módulo (lógica "OR"). FALSE: Error de módulo Error de canal de un canal (no errores externos) Módulo no introducido.			
		_	Observe el parámetro "Module Status".			
Module Status	DWORD	R	Estado del módu			
			Codificación	Descripción		
			0x00000001	Error del módulo 1)		
			0x00000002	Umbral de temperatura 1 excedido		
			0x00000004	Umbral de temperatura 2 excedido		
			0x00000008	Valor de temperatura erróneo		
			0x00000010	Tensión L1+ errónea		
			0x00000020	Tensión L2+ errónea		
			0x00000040	Tensiones internas erróneas		
			0x80000000	Sin conexión al módulo 1)		
			1) Estos errores tienen repercusiones sobre el estado <i>Module OK</i> y no es necesario evaluarlos explícitamente en el programa del usuario.			
Timestamp [µs]	DWORD	R	Parte en microsegundos de la marca de tiempo. Momento de la medición de las salidas digitales			
Timestamp [s] DWORD		R	Parte en segundos de la marca de tiempo. Momento de la medición de las salidas digitales			

Tabla 16: Ficha "Module" del editor de hardware

Página 34 de 52 HI 801 225 ES Rev. 4.00

X-DO 32 51 4 Puesta en servicio

4.3.2 Ficha I/O Submodule DO32_51

La ficha I/O Submodule DO32 51 contiene los siguientes parámetros del sistema.

Name		R/W	Descripción			
Estos estados y parámetros se escriben directamente en el editor de hardware.						
Name		W	No es posible modificar el nombre del módulo			
Name	Tipo de datos	R/W	Descripción			
Los siguientes estados y del usuario.	/ parámetros	s podrán	asignarse a variables globales y utilizarse en el programa			
Background Test Error	DINT	W	TRUE: Prueba en segundo plano errónea FALSE: Prueba en segundo plano exenta de errores			
Diagnostic Request	DINT	R	Para solicitar un valor de diagnóstico, deberá enviarse al módulo el correspondiente ID (ver codificación en 4.3.5) mediante el parámetro <i>Diagnostic Request</i> .			
Diagnostic Response	DWORD	R	Una vez que <i>Diagnostic Response</i> devuelva el ID (ver codificación en 4.3.5) de <i>Diagnostic Request</i> , en <i>Diagnostic Status</i> se tendrá el valor de diagnóstico solicitado.			
Diagnostic Status	BOOL	R	Valor de diagnóstico solicitado conforme a <i>Diagnostic Response</i> En el programa del usuario se podrán evaluar los ID de <i>Diagnostic Request</i> y de <i>Diagnostic Response</i> . Sólo cuando ambos contengan el mismo ID, contendrá <i>Diagnostic Status</i> el valor de diagnóstico solicitado.			
Restart on Error	BOOL	W	Todo módulo de E/S que esté desactivado prolongadamente a causa de errores podrá ponerse de nuevo en estado RUN mediante el parámetro Restart on Error. Para ello cambie el parámetro Restart on Error de FALSE a TRUE. El módulo de E/S realizará una autocomprobación completa y adoptará el estado RUN si no detecta ningún error. Configuración por defecto: FALSE			
Submodule OK	BOOL	R	TRUE: Sin errores de submódulo Sin errores de canal FALSE: Error de submódulo Error de canal (también errores externos) de un canal			
Submodule Status	DWORD	R	Estado del submódulo codificado en bits (ver codificación en 4.3.4)			

Tabla 17: Ficha I/O Submodule DO32_51 del editor de hardware

HI 801 225 ES Rev. 4.00 Página 35 de 52

4 Puesta en servicio X-DO 32 51

4.3.3 Ficha I/O Submodule DO32_51: Channels

La ficha **I/O Submodule DO32_51:Channels** contiene los siguientes parámetros de sistema para cada salida digital.

A los parámetros de sistema con -> pueden asignárseles variables globales y utilizarse en el programa del usuario. Los valores sin -> deberá Ud. escribirlos directamente.

Name	Tipo de datos	R/W	Descripción
Channel No.		R	Nº de canal, predefinido por defecto
Channel Value [BOOL] ->	BOOL	R	Valor binario según el nivel de conmutación LOW (dig) y HIGH (dig). TRUE: Canal activado FALSE: Canal desactivado
-> Channel OK	BOOL	R	TRUE: Canal exento de errores El valor del canal será válido FALSE: Canal erróneo Canal desactivado
Redund.	BOOL	W	Requisitos: deberá haber creado un módulo redundante. Activado: activación de la redundancia de canal para ese canal Desactivado: desactivación de la redundancia de canal para ese canal Configuración por defecto: Desactivado

Tabla 18: I/O Submodule DO32_51: Canales en el editor de hardware

Página 36 de 52 HI 801 225 ES Rev. 4.00

X-DO 32 51 4 Puesta en servicio

4.3.4 Submodule Status [DWORD]

Codificación de la variable Submodule Status:

Codificación	Descripción
0x0000001	Error de la unidad de hardware (submódulo)
0x00000002	Reset de un bus de E/S
0x00000004	Error en la configuración del hardware
0x00000008	Error en la comprobación de coeficientes
0x0000010	Primer umbral de temperatura excedido (temperatura de advertencia)
0x00000020	Segundo umbral de temperatura excedido (temperatura límite)
0x00000040	Sobreintensidad, módulo desactivado
0x00000080	Reinicialización del monitoreo de CS (selección de chip)
0x04000000	Monitoreo de la tensión L1+: Tensión LOW errónea
0x10000000	Monitoreo de la tensión L2+: Tensión LOW errónea.
0x20000000	Monitoreo de la tensión errónea AGND

Tabla 19: Submodule Status [DWORD]

HI 801 225 ES Rev. 4.00 Página 37 de 52

4 Puesta en servicio X-DO 32 51

4.3.5 Diagnostic Status [DWORD]

Codificación de Diagnostic Status.

ID	Descripción				
0	Los valores de diagnóstico (1001032) se mostrarán consecutivamente.				
100	Estado de temperatura codificado en bits				
	0 = normal				
		it0 = 1 : Umbral de temperatura 1 excedido			
	Bit1 = 1 : Umbral de temperatura 2 excedido				
	Bit2 = 1 : Medición de temperatura errónea				
101	temperatura medida (10 000 dígitos/°C)				
200	Estado de tensión codificado en bits				
	0 = normal				
	Bit0 = 1 : L1+ (24 V) errónea				
	Bit1 = 1 : L2+ (24 V) errónea				
201	No se usa				
202					
203					
300	Subtensión de 24 V (BOOL)				
10011032	nales 132				
	Codificación	Descripción			
	0x0001	Se ha producido un error de la unidad de hardware (submódulo)			
	0x0002	Error de canal debido a error interno			
	0x0004	Sobreintensidad, canal desactivado			

Tabla 20: Diagnostic Information [DWORD]

Página 38 de 52 HI 801 225 ES Rev. 4.00

X-DO 32 51 4 Puesta en servicio

4.4 Variantes de conexión

Este capítulo describe el correcto circuitado instrumentado del módulo. Son admisibles las siguientes variantes de conexión.

Las salidas se ponen en circuito mediante tarjetas de conexión. Para una redundante puesta en circuito se dispone de tarjetas de conexión especiales. Véase el capítulo 3.6.

Para conectar cargas a las salidas observe los siguientes puntos:

- Si se conectan cargas inductivas, será obligatorio un circuito de protección (diodo de retorno, varistor o similar).
- Es admisible conectar cables no apantallados de par trenzado.
- No se permite interconectar los cables de masa de las salidas.

4.4.1 Circuitado de actuadores mediante conexión monopolo

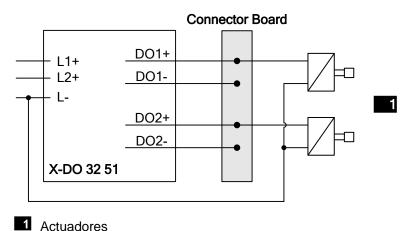


Fig. 12: Circuitado de amplificadores y actuadores mediante conexión monopolo

4.4.2 Circuitado de actuadores mediante conexión a dos polos

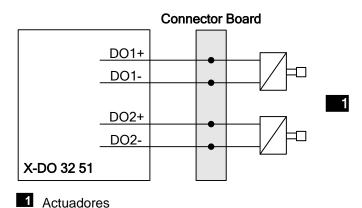
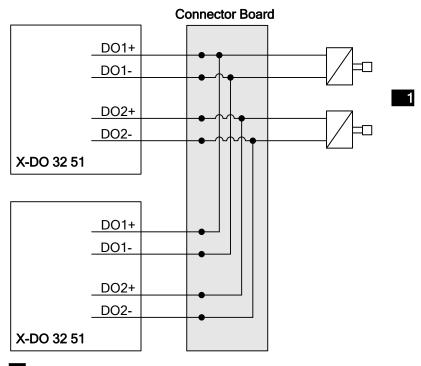


Fig. 13: Circuitado de actuadores mediante conexión a dos polos

HI 801 225 ES Rev. 4.00 Página 39 de 52

4 Puesta en servicio X-DO 32 51

4.4.3 Circuitado redundante de actuadores



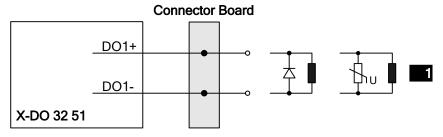
1 Actuadores

Fig. 14: Circuitado redundante de actuadores

La puesta en circuito de más arriba será admisible sólo si ambos canales tienen el mismo número de canal.

4.4.4 Circuitado de cargas inductivas

Si se conectan cargas inductivas, será obligatorio conectar un circuito de protección (diodo de retorno, varistor o similar) en paralelo a la carga.



Cargas inductivas con circuitados de conexión

Fig. 15: Circuitado de cargas inductivas

Página 40 de 52 HI 801 225 ES Rev. 4.00

X-DO 32 51 4 Puesta en servicio

4.4.5 Conexión de actuadores mediante terminación FTA (Field Termination Assembly)

La conexión de actuadores mediante el bloque de terminación de campo X-FTA 002 01 se realiza como se ilustra en la Fig. 16. Hallará más información en el manual X-FTA 002 01 HI 801 229 ES.

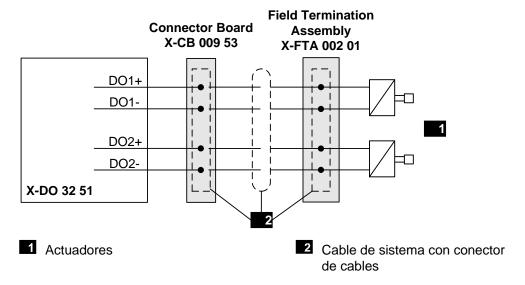


Fig. 16: Conexión de actuadores mediante terminación FTA (Field Termination Assembly)

HI 801 225 ES Rev. 4.00 Página 41 de 52

5 Funcionamiento X-DO 32 51

5 Funcionamiento

El módulo opera en un rack HIMax y no necesita de monitoreo especial.

5.1 Manejo

No se contempla ninguna operación de manejo en el módulo en sí.

Operaciones como p. ej. el forzado de las salidas se realizan en el PADT. Hallará más información al respecto en la documentación de SILworX.

5.2 Diagnóstico

El estado del módulo se indica mediante LEDs en la cara frontal del módulo. Véase el capítulo 3.4.2.

El historial de diagnóstico del módulo puede además leerse con la utilidad de programación SILworX. En los capítulos 4.3.4 y 4.3.5 se describen los mensajes de diagnóstico más importantes del módulo.

Si en un rack se encaja un módulo, éste generará mensajes de diagnóstico durante la inicialización, los cuales apuntarán a disfunciones tales como valores de tensión incorrectos.

Estos mensajes denotarán un error del módulo sólo cuando se produzcan tras la transición al estado de sistema en funcionamiento.

Página 42 de 52 HI 801 225 ES Rev. 4.00

X-DO 32 51 6 Mantenimiento

6 Mantenimiento

Los módulos averiados deberán sustituirse con módulos intactos del mismo tipo o de un tipo de reemplazo homologado.

La reparación del módulo está reservada al fabricante.

Para sustituir módulos deberán observarse las condiciones indicadas en el manual del sistema HI 801 141 ES y el manual de seguridad HI 801 196 ES.

6.1 Tareas de mantenimiento

6.1.1 Carga del sistema operativo

En el marco del mantenimiento perfectivo, HIMA sigue desarrollando el sistema operativo del módulo. HIMA recomienda aprovechar paradas programadas de la línea para cargar la versión actual del sistema operativo a los módulos.

La carga del sistema operativo se describe en el manual del sistema y en la ayuda directa en pantalla. Para cargar el sistema operativo, el módulo deberá encontrarse en estado STOP.

La versión actual del módulo figura en el panel de control de SILworX. La placa de tipo indica la versión instalada a la entrega de fábrica, véase el capítulo 3.3.

6.1.2 Ensayo de prueba

Los módulos HIMax deben someterse a un ensayo de prueba cada 10 años. Hallará más información en el manual de seguridad HI 801 196 ES.

HI 801 225 ES Rev. 4.00 Página 43 de 52

7 Puesta fuera de servicio X-DO 32 51

7 Puesta fuera de servicio

Saque el módulo del rack para ponerlo fuera de servicio. Más información en el capítulo *Instalación y desmontaje del módulo*.

Página 44 de 52 HI 801 225 ES Rev. 4.00

X-DO 32 51 8 Transporte

8 Transporte

Para evitar daños mecánicos, transporte los componentes HIMax empaquetados.

Guarde los componentes HIMax siempre empaquetados en su embalaje original. Éste sirve además como protección contra descargas ES. El embalaje del producto solo no es suficiente para el transporte.

HI 801 225 ES Rev. 4.00 Página 45 de 52

9 Desecho X-DO 32 51

9 Desecho

Los clientes industriales son responsables de desechar ellos mismos el hardware de HIMax tras la vida útil del mismo. Si se desea puede solicitarse a HIMA la eliminación de los componentes usados.

Deseche todos los materiales respetuosamente con el medio ambiente.

Página 46 de 52 HI 801 225 ES Rev. 4.00

X-DO 32 51 Anexo

Anexo

Glosario

Término	Descripción	
ARP	Address Resolution Protocol: protocolo de red para asignar direcciones	
	de red a direcciones de hardware	
Al	Analog input: entrada analógica	
Connector Board	Tarjeta de conexión para módulo HIMax	
COM	Módulo de comunicación	
CRC	Cyclic Redundancy Check: suma de verificación	
DI	Digital input: entrada digital	
DO	Digital output: salida digital	
CEM	Compatibilidad electromagnética	
EN	Normas europeas	
ESD	ElectroStatic Discharge: descarga electrostática	
FB	Bus de campo	
FBS	Lenguaje de bloques funcionales	
FTT	Tiempo de tolerancia de errores	
ICMP	Internet Control Message Protocol: protocolo de red para mensajes de estado	
	y de error	
IEC	Normas internacionales de electrotecnia	
Dirección MAC	Dirección de hardware de una conexión de red (Media Access Control)	
PADT	Programming and Debugging Tool (según IEC 61131-3), PC con SILworX	
PE	Tierra de protección	
PELV	Protective Extra Low Voltage: baja tensión funcional con separación segura	
PES	Programmable Electronic System	
PFD	Probability of Failure on Demand: probabilidad de un fallo al solicitar una función de seguridad	
PFH	Probability of Failure per Hour: probabilidad de una disfunción peligrosa por hora	
R	Read	
ID de Rack	Identificación (número) de un rack	
Sin repercusiones		
R/W	Read/Write	
SB	Bus de sistema (módulo de bus)	
SELV	Safety Extra Low Voltage: baja tensión de protección	
SFF	Safe Failure Fraction: porcentaje de fallos fácilmente dominables	
SIL	Safety Integrity Level (según IEC 61508)	
SILworX	Utilidad de programación para HIMax	
SNTP	Simple Network Time Protocol (RFC 1769)	
SRS	Direccionamiento por "Sistema.Rack.Slot" de un módulo	
SW	Software	
TMO	TimeOut	
TMR	Triple Module Redundancy: módulos de triple redundancia	
W	Write	
wS	Valor máximo del total de componentes de corriente alterna	
WatchDog (WD)		
WDT	WatchDog Time	
	1	

HI 801 225 ES Rev. 4.00 Página 47 de 52

Anexo X-DO 32 51

Índice de	ilustraciones	
Fig. 1:	Ejemplo de placa de tipo	11
Fig. 2:	Diagrama de bloques	13
Fig. 3:	Lectura	14
Fig. 4:	Vistas	17
Fig. 5:	Ejemplo de una codificación	20
Fig. 6:	Tarjetas de conexión con bornes de rosca	21
Fig. 7:	Tarjetas de conexión con conector de cables	24
Fig. 8:	X-CA 006 01 n	26
Fig. 9:	Colocación de la tarjeta de conexión	29
Fig. 10:	Atornillado de la tarjeta de conexión	30
Fig. 11:	Instalación y desmontaje de módulo	32
Fig. 12:	Circuitado de amplificadores y actuadores mediante conexión monopolo	39
Fig. 13:	Circuitado de actuadores mediante conexión a dos polos	39
Fig. 14:	Circuitado redundante de actuadores	40
Fig. 15:	Circuitado de cargas inductivas	40
Fig. 16:	Conexión de actuadores mediante terminación FTA (Field Termination Assembly)	41

Página 48 de 52 HI 801 225 ES Rev. 4.00

X-DO 32 51 Anexo

Índice de	e tablas	
Tabla 1:	Manuales vigentes adicionales	5
Tabla 2:	Condiciones ambientales	8
Tabla 3:	Frecuencias de parpadeo de los LED	15
Tabla 4:	Indicadores de estado de módulo	15
Tabla 5:	Indicadores de bus de sistema	16
Tabla 6:	LED indicadores de E/S	16
Tabla 7:	Datos del producto	17
Tabla 8:	Datos de las salidas digitales	18
Tabla 9:	Tarjetas de conexión disponibles	19
Tabla 10:	Posición de las cuñas de codificación	20
Tabla 11:	Asignación de bornes de tarjetas de conexión con bornes de rosca	22
Tabla 12:	Características de los conectores de bornes	23
Tabla 13:	Asignación de conectores del cable del sistema	25
Tabla 14:	Datos de cables	26
Tabla 15:	Cables de sistema disponibles	26
Tabla 16:	Ficha "Module" del editor de hardware	34
Tabla 17:	Ficha I/O Submodule DO32_51 del editor de hardware	35
Tabla 18:	I/O Submodule DO32_51: Canales en el editor de hardware	36
Tabla 19:	Submodule Status [DWORD]	37
Tabla 20:	Diagnostic Information [DWORD]	38

HI 801 225 ES Rev. 4.00 Página 49 de 52

Anexo X-DO 32 51

Índice alfabético

Diagnóstico	Indicadores de estado de módulo15
Indicadores de bus de sistema16	Tarjeta de conexión
Indicadores de E/S16	Con bornes de rosca21
Diagrama de bloques13	Con conector de cables24
Función de seguridad11	

Página 50 de 52 HI 801 225 ES Rev. 4.00



HI 801 225 ES © 2015 HIMA Paul Hildebrandt GmbH HIMax y SILworX son marcas registradas de: HIMA Paul Hildebrandt GmbH

Albert-Bassermann-Str. 28 68782 Brühl, Alemania Tel. +49 6202 709-0 Fax +49 6202 709-107 HIMax-info@hima.com www.hima.com



